

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-24

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Przydział obligacji imiennych serii H

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

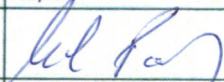
Zarząd Module Technologies SA („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 r., dokonał przydziału obligacji imiennych serii H o łącznej wartości, zarówno nominalnej jak i emisyjnej, 7 301 000 zł (siedem milionów trzysta jeden tysięcy złotych). O zamiarze emisji obligacji Spółka powiadamiała w raporcie bieżącym EBI nr 12/2019 z 11 marca 2019 r.

Przydział nastąpił na rzecz 87 podmiotów (osób fizycznych) w trybie określonym w art. 33 pkt 2) ustawy z 15 stycznia 2015 roku o obligacjach.

Obligacje podlegać będą wykupowi po okresie 36 miesięcy od dnia emisji (rozumianego jako dzień przydziału obligacji), będą oprocentowane w wysokości 8,25 procent w stosunku rocznym, płatność odsetek będzie następowała w kwartalnych okresach odsetkowych.

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
MODULE TECHNOLOGIES S.A.		Usługi inne (uin)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
43-300	Bielsko-Biała		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Hugona Kollataja		14/6	
	(ulica)	(numer)	
+48 32 210 18 26		+48 32 210 18 26	
(telefon)		(fax)	
zarzad@lstechhomes.com		www.lstechhomes.com	
(e-mail)		(www)	
5472105335		241140645	
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-24	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2019-04-24	Daniel Pihan	Członek Zarządu	